



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103433711 A

(43) 申请公布日 2013.12.11

(21) 申请号 201310408627.6

(22) 申请日 2013.09.10

(71) 申请人 遵义市节庆机电有限责任公司

地址 563000 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区

(72) 发明人 杨盛强

(74) 专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212

代理人 李雪梅

(51) Int. Cl.

B23P 15/00 (2006.01)

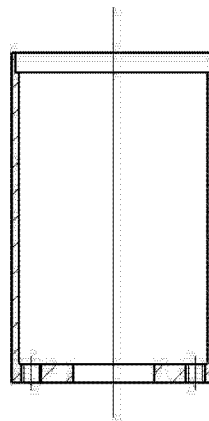
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种壳体的加工工艺

(57) 摘要

本发明涉及一种壳体的加工工艺,其具体步骤为:(1)按照零件要求选用相应棒料,上车床,平端面,车内、外圆至尺寸要求;按单件尺寸要求割断,留1mm余量;(2)调头,平端面至尺寸要求;扩孔至尺寸要求;精车内圆至尺寸要求,保证表面粗糙度;(3)从左侧套入与内圆匹配的自制芯轴,装夹后精车外圆至尺寸要求,保证外表面粗糙度;(4)数控铣床装夹后钻螺纹底孔,去毛刺;(5)采用自制定位夹具上数控铣床后铣缺口;(6)攻丝机攻螺纹,去毛刺。本发明加工工艺为避免加工过程中因壁薄产生变形,特别自制与内圆相匹配的芯轴以保证零件的加工,故产品的合格率达95%以上,完全满足产品的使用要求。



1. 一种壳体的加工工艺,其特征在于:所述加工工艺的具体步骤为:

(1)、按照零件要求选用相应棒料,上车床,平端面,车内、外圆至尺寸要求;按单件尺寸要求割断,留 1 mm 余量;

(2)、调头,平端面至尺寸要求;扩孔至尺寸要求;精车内圆至尺寸要求,保证表面粗糙度;

(3)、从左侧套入与内圆匹配的自制芯轴,装夹后精车外圆至尺寸要求,保证外表面粗糙度;

(4)、数控铣床装夹后钻螺纹底孔,去毛刺;

(5)、采用自制定位夹具上数控铣床后铣缺口;

(6)、攻丝机攻螺纹,去毛刺。

一种壳体的加工工艺

技术领域

[0001] 本发明属于机加工领域,特别涉及一种壳体的加工工艺。

[0002]

背景技术

[0003] 在机加工行业,各种各样的零件加工都会碰到,壳体的加工很普遍,但对于薄壁壳体的加工,却是很头痛的问题,因为薄壁壳体在加工过程中很容易产生变形以致于不能满足使用要求。

[0004]

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供一种薄壁壳体的加工工艺。

[0006] 一种壳体的加工工艺,其具体步骤为:

(1)、按照零件要求选用相应棒料,上车床,平端面,车内、外圆至尺寸要求;按单件尺寸要求割断,留 1 mm 余量;

(2)、调头,平端面至尺寸要求;扩孔至尺寸要求;精车内圆至尺寸要求,保证表面粗糙度;

(3)、从左侧套入与内圆匹配的自制芯轴,装夹后精车外圆至尺寸要求,保证外表面粗糙度;

(4)、数控铣床装夹后钻螺纹底孔,去毛刺;

(5)、采用自制定位夹具上数控铣床后铣缺口;

(6)、攻丝机攻螺纹,去毛刺。

[0007] 本发明加工工艺为避免加工过程中因壁薄产生变形,特别自制与内圆相匹配的芯轴以保证零件的加工,故产品的合格率高达 95% 以上,完全满足产品的使用要求。

[0008]

附图说明

[0009] 图 1 为本发明样件壳体的主视图;

图 2 为本发明样件壳体的俯视图。

[0010]

具体实施方式

[0011] 随着科技的不断进步,现在生活中电脑已普遍走进人们的生活,随着电脑的普通,电脑上的各种零件需求也越来越大,电脑上的即插件非常多,且精度要求也非常高。如图 1、图 2 所示为本发明样件的主、俯视图。样件为即插件中的一种壳体。

[0012] 一种壳体的加工工艺,其具体步骤为:

(1)、按照零件要求选用相应棒料,上车床,平端面,车内、外圆至尺寸要求;按单件尺寸要求割断,留 1 mm 余量;

(2)、调头,平端面至尺寸要求;扩孔至尺寸要求;精车内圆至尺寸要求,保证表面粗糙度;

(3)、从左侧套入与内圆匹配的自制芯轴,装夹后精车外圆至尺寸要求,保证外表面粗糙度;

(4)、数控铣床装夹后钻螺纹底孔,去毛刺;

(5)、采用自制定位夹具上数控铣床后铣缺口;

(6)、攻丝机攻螺纹,去毛刺。

[0013] 采用本发明加工工艺,可以保证薄壁壳体的变形量小,产品合格率高,最大限度的满足使用要求。

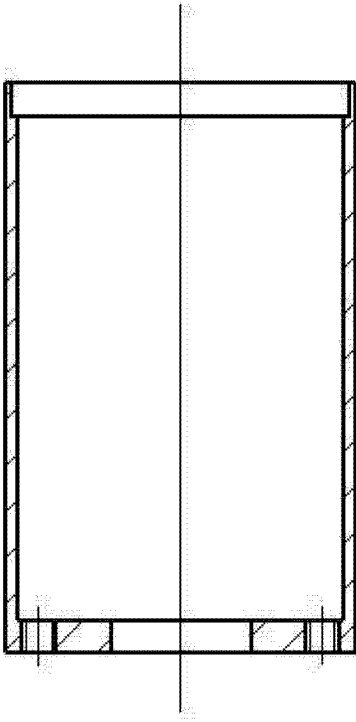


图 1

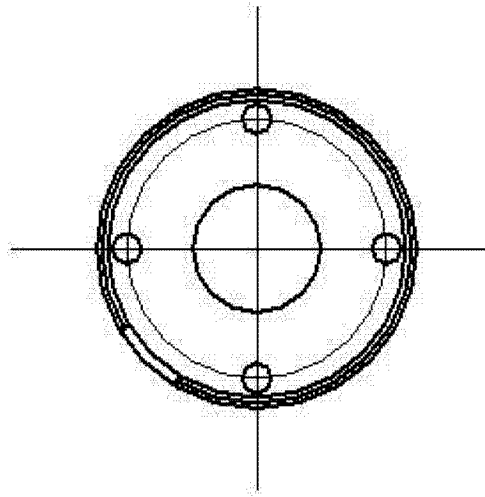


图 2